



导热胶带

## 性能

- 高性能、高导热
- 可提供压敏及热固化两种方案
- 提供出色的电绝缘性
- 与器件表面均有优秀的浸润性

## 主要应用

- 图形处理器
- 电动机控制板
- 电力变换及控制板
- 驱动处理器



粘接



固态





导热胶带



产品	描述	导热系数 (W/m-k)	厚度 (mm)	操作温度	固化方式	阻燃等级 (UL 94)
<a href="#">BERGQUIST BOND PLY TBP 1400LMS-HD</a>	有机硅, 高耐久性层压材料	1.4	0.254-0.457	-60 - 180 °C	30 分钟 @ 125°C 6 分钟 @ 160°C	V-0
<a href="#">BERGQUIST BOND PLY TBP 800</a>	玻纤增强丙烯酸压敏胶带	0.8	0.127-0.203	-40 - 125 °C	压敏	V-0
<a href="#">BERGQUIST BOND PLY TBP 850</a>	玻纤增强丙烯酸压敏导热胶带	0.8	0.127-0.279	-30 - 120 °C	压敏	V-0
<a href="#">BERGQUIST BOND PLY TBP 400</a>	加强型丙烯酸压敏导热胶带	0.4	0.076-0.254	-30 - 120°C	压敏	V-0
<a href="#">BERGQUIST BOND PLY TBP 400P</a>	加强型丙烯酸压敏导热胶带	0.4	0.203	-40 - 125°C	压敏	V-0